

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

333483

ML8

Erstellt:

Nies, Andreas

Kunde:

AV RT

Datum:

29.01.2024



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	115		2
C-RAS-PP-106-460x305-TG150HF-ung-PAN-...	50202632	0		3
		35	L2	
A-RAS-ML-0.125-035+035-460x305-TG150HF...	50202544	125		4
		35	L3	
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	115		5
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	0		6
		35	L4	
A-RAS-ML-0.125-035+035-460x305-TG150HF...	50202544	125		7
		35	L5	
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	115		8
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	0		9
		35	L6	
A-RAS-ML-0.125-035+035-460x305-TG150HF...	50202544	125		10
		35	L7	
C-RAS-PP-106-460x305-TG150HF-ung-PAN-...	50202632	115		11
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	0		12
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	13

Dicke nach Verpressen

B00:

1090 µm

Tol+:

120 µm

Tol-:

120 µm

Dmax:

1210 µm

Dmin:

970 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1200 µm

Tol+:

120 µm

Tol-:

120 µm

Dmax:

1320 µm

Dmin:

1080 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1081 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik